中信建投证券股份有限公司

关于

强一半导体（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭家兴、张宇辰根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 3
一、普通术语 3
二、专业术语 5
第一节 本次证券发行基本情况 8
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 8
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 9
三、发行人基本情况 12
四、保荐人与发行人关联关系的说明 12
五、保荐人内部审核程序和内核意见 13
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14
第二节 保荐人承诺事项 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 18
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 18
第四节 关于发行人利润分配政策的核查 20
第五节 对本次发行的推荐意见 21
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 21
二、本次发行符合相关法律规定 22
三、发行人的主要风险提示 26
四、发行人的发展前景评价 29
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 36
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论 36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语

保荐人、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、本公司、强一股份、强一半导体	指	强一半导体（苏州）股份有限公司
强一有限	指	强一半导体（苏州）有限公司，发行人前身
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
发行保荐书、本发行保荐书	指	《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》
韩国强一	指	强一半导体（韩国）有限公司，发行人全资子公司，已于 2024 年 8 月注销
新沂强一	指	新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控制的其他企业，发行人持股平台
知强合一	指	新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控制的其他企业，发行人持股平台
众强行一	指	新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控制的其他企业，发行人持股平台
丰年君和	指	宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
哈勃科技	指	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
元禾璞华	指	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州聿泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
海风	指	HAI FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED，发行人股东
联发利宝	指	联发利宝（香港）有限公司，发行人股东
善润明曜	指	海南善润明曜股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
冯源绘芯	指	晋江冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名平潭冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
北京集成	指	北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙），发行人股东

鹏晨讯达	指	深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中信科	指	湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
联和三期	指	厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
凯腾瑞杰	指	南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙），发行人股东
杭州津泰	指	杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
共青城玖沛	指	共青城玖沛投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名共青城玖沛投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
领益基石	指	南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
汇科聚睿	指	合肥汇科聚睿创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
清石玖华	指	苏州清石玖华创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州毅和	指	苏州毅和新材料创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
朗玛七十四号	指	朗玛七十四号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人股东
联和二期	指	厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
Ondine	指	OndineMMD Limited，发行人股东
南钢星博	指	无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
置信信远	指	北京置信信远股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
浙港春霖	指	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
国发创投	指	苏州上银国发创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
联新三期	指	上海联新三期创业投资中心（有限合伙），发行人股东
武汉光宏	指	武汉光宏科创投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
嘉兴豫富	指	嘉兴豫富君泺壹号投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
朗玛七十三号	指	朗玛七十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人股东
嘉兴君晋	指	嘉兴君晋股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波先达	指	宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
丽水同达	指	丽水同达创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波同达创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
松川科技	指	海南经济特区松川科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
丰聚年佳	指	共青城丰聚年佳投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
复星奥来德	指	无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广安小平	指	广安小平故里发展基金中心（有限合伙），发行人股东
共青城芯微	指	共青城芯微投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

南通圆周率	指	圆周率半导体（南通）有限公司，控股股东、实际控制人控制的其他企业
B 公司	指	在本发行保荐书中指代与公司有交易的同受 A 公司控制的相关交易主体。B 公司系全球领先的芯片设计厂商，包括 B1 公司、B2 公司以及 B3 公司等
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司，一家全球领先的从事 NOR Flash 开发的芯片设计厂商，中国上海证券交易所科创板上市公司，证券代码：603986.SH
合肥长鑫	指	长鑫科技集团股份有限公司，最大的国产 DRAM IDM 厂商
长江存储	指	长江存储科技控股有限责任公司，最大的国产 NAND Flash IDM 厂商
TechInsights	指	TechInsights Inc.，一家总部位于加拿大的咨询公司，系全球知名的半导体行业信息数据提供商
WSTS	指	WSTS Inc.是一家总部位于美国的非营利性共同利益公司，致力于提供可靠的半导体行业数据和预测
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	上市后适用的《强一半导体（苏州）股份有限公司章程（草案）》
报告期	指	2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日
申报会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业术语

探针卡	指	一种应用于半导体晶圆测试的硬件，是测试机与待测晶圆的接触媒介
晶圆	指	制造芯片等产品的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
封装测试	指	封装系为芯片安装外壳，起到安放、固定、密封、保护芯片等作用；测试系检测封装前后的芯片性能、功能等是否可正常运作、是否符

		合设计规格
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，以微电子、微机械及材料科学为基础，研究、设计、制造具有特定功能的微型器件，MEMS 工艺可以将器件加工至极高的精度
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、硒、锗等
晶体管	指	二极管、三极管、场效应晶体管等半导体器件的泛称
集成电路	指	是一种微型电子部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体（硅、锗等）或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件
稼动率	指	设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重
PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造工厂，是集芯片设计、晶圆制造、封装测试以及销售于一体的整合元件制造商，属于半导体产业的一种业务模式
SoC	指	System on Chip，将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
AP	指	Application Process，手机应用处理器最主要的部分，操作系统、用户界面和应用程序均在 AP 上执行
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
GPU	指	Graphics Processing Unit，图形处理器，它一般是在电脑、手机等设备上做图像和图形相关运算工作的处理器
NPU	指	Neural network Processing Unit，神经网络处理器，用于深度学习计算的处理器架构，通常用于移动设备、嵌入式设备和高性能计算领域
FPGA	指	Field-Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，用户可通过程序指定实现某一特定功能的芯片
CIS	指	CMOS Image Sensor，将光学图像转换成电子信号的电子器件
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，属于易失性存储器，即断电后数据即会丢失
NAND Flash	指	非易失性存储器的一种，需要外接的主控电路读取其中的数据，容量较大，主要应用于 U 盘、固态硬盘、手机存储等
NOR Flash	指	非易失性存储器的一种，不需要专门的接口电路，可以在其内部运行程序，容量较小，一般用于存储一些初始化内存的固件代码
米/m、毫米/mm、微米/μm、纳米/nm	指	长度单位，1 米=1,000 毫米=1,000,000 微米=1,000,000,000 纳米
空间转接基板	指	连接探针与探针卡 PCB 的一种装置，主要包括 MLC、MLO 等，实

		现信号由晶圆级信号间距（一般<200 微米）到 PCB 可制造间距（一般>300 微米）的转换以达到更好的测试效果
MLC	指	Multi-Layer Ceramic，多层陶瓷基板，主要通过陶瓷材料制造而成的空间转接基板
MLO	指	Multi-Layer Organic，多层有机基板，主要通过有机材料制造而成的空间转接基板
SiP	指	System in Package，将多种功能芯片，包括逻辑芯片、存储芯片等功能芯片以及多种电子元器件通过并排或叠加的封装方式集成在一个封装体内，从而实现一个基本完整的功能
HBM	指	High Bandwith Memory，高带宽内存，一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM。具有高性能、高带宽、高容量、低功耗、高可靠性的 GPU 内存，可以广泛应用于高性能计算、人工智能和图形处理等领域

在本发行保荐书中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

本发行保荐书所引用的部分数据来自 TechInsights 定期发布的相关探针卡行业报告，发行人购买该等报告支付正常订阅费用，但并非为本次发行上市专门定制。除此之外的其他有关行业统计数据及资料均来自不同的公开刊物、研究报告、网站等公开信息，公司未为该等第三方数据及资料支付费用或提供帮助。另外，本发行保荐书中的中国集成电路、中国半导体探针卡行业市场规模等均未纳入中国台湾地区情况。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定郭家兴、张宇辰担任本次强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

郭家兴先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目；歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目；山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票项目；北京旋极信息技术股份有限公司股权激励财务顾问项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张宇辰先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；成都高新发展股份有限公司非公开发行股票项目；歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目；无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目、陕西建设机械股份有限公司重大资产重组项目、甘肃盛达集团股份有限公司收购甘肃皇台酒业股份有限公司项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为李书春，其执业情况如下：

李书春先生：中国注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目；甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括杨志、童宏杰、赵鸿川、荣光玉、黄泽森、莫凡人、李恒、吴天健、关峰、孙中凯、鲁坤。

杨志先生：具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目；甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

童宏杰先生：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、常州同惠电子股份有限公

司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

赵鸿川先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目；云南省城市建设投资集团有限公司要约收购云南城投置业股份有限公司项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

荣光玉先生：中国注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄泽森先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

莫凡人先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券项目、招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券项目、青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券项目、山东招金集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券项目、招金矿业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券项目；天津融诚物产集团有限公司收购四川浩物机电股份有限公司项目；奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目；北京海金格医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李恒先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务

管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吴天健先生：具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

关峰先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票并在深交所上市项目、苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目；中航电测仪器股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目、北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目；歌尔股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、通鼎互联信息股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

孙中凯先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目；苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目；奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

鲁坤先生：硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合

格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、发行人基本情况

公司名称：	强一半导体（苏州）股份有限公司
注册地址：	苏州工业园区东长路 18 号 39 幢 2 楼
成立时间：	2015 年 8 月 28 日
注册资本：	9,716.9418 万元
法定代表人：	周明
董事会秘书：	张子涵
联系电话：	0512-80784831-8024
互联网地址：	http://www.maxonesemi.com
主营业务：	公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售
本次证券发行的类型：	首次公开发行股票并在科创板上市

四、保荐人与发行人关联关系的说明

（一）截至本发行保荐书签署日，发行人保荐人、主承销商中信建投证券的全资子公司中信建投投资有限公司及中信建投资本管理有限公司通过北京集成、浙港春霖、置信信远间接持有发行人 0.81%的股份，除上述情况外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行

人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，或在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）保荐人关于本项目的内部审核程序

本保荐人在向中国证监会、上交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

1、项目的立项审批

本保荐人按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2022 年 10 月 24 日得到本保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意。

2、投行委质控部的审核

本保荐人在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

2024 年 11 月 11 日至 11 月 15 日，投行委质控部对本项目进行了现场核查；2024 年 11 月 25 日，项目组向投行委质控部提出底稿验收申请；底稿验收申请通过后，2024 年 11 月 26 日，投行委质控部对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

3、内核部门的审核

本保荐人投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2024 年 11 月 28 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2024 年 12 月 4 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上交所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐人为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会、上交所正式推荐本项目。

（二）保荐人关于本项目的内核意见

本次发行申请符合《公司法》《证券法》、中国证监会相关法规规定以及上交所的有关业务规则的发行条件，同意作为保荐人向中国证监会、上交所推荐。

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查

（一）核查对象

本保荐人对截至本发行保荐书签署日发行人在册股东中是否有私募投资基金及其是否按规定履行备案程序情况进行了核查。

（二）核查方式

本保荐人履行的核查方式包括查阅发行人股东的股东名册、工商登记资料、营业执照、公司章程、合伙协议、备案登记资料以及通过中国证券投资基金业协会网站查询私募基金备案情况等。

（三）核查结果

截至本发行保荐书签署日，发行人共有 44 名股东，其中机构股东 40 名，自然人股

东 4 名。机构股东中 30 名股东为私募基金，均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定进行登记或备案，具体情况如下：

序号	股东名称	基金备案号	基金管理人名称	管理人登记编号
1	丰年君和	SX2537	宁波丰年荣通投资管理有限公司	P1015651
2	元禾璞华	SCW352	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	P1067993
3	善润明曜	SQS463	北京瑞植资产管理有限公司	P1067168
4	冯源绘芯	SNL252	冯源（宁波）私募基金管理有限公司	P1071503
5	北京集成	SND737	北京诺华资本投资管理有限公司	P1070805
6	鹏晨讯达	SNF172	深圳市前海鹏晨投资管理有限公司	P1034482
7	中信科	SJM005	武汉光谷烽火投资基金管理有限公司	P1065947
8	联和三期	SEK608	厦门市联和股权投资基金管理有限公司	P1066751
9	凯腾瑞杰	SD5698	江苏凯腾创业投资有限公司	P1011378
10	杭州津泰	SND221	天津泰达科技投资股份有限公司	P1001349
11	共青城玖沛	SVQ252	北京融沛资本管理有限公司	P1004848
12	领益基石	SQZ879	基石资产管理股份有限公司	P1002245
13	汇科聚睿	SZA058	上海正心谷投资管理有限公司	P1017489
14	清石玖华	SXV018	清石资产管理（上海）有限公司	P1070825
15	苏州毅和	STS414	苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司	P1069021
16	朗玛七十四号	SXP856	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
17	联和二期	SND978	厦门市联和股权投资基金管理有限公司	P1066751
18	南钢星博	SXK728	上海复星创富投资管理股份有限公司	P1000303
19	置信信远	SNZ950	北京中安置信私募基金管理有限公司	P1071820
20	浙港春霖	STQ721	中信建投资本管理有限公司	GC2600011623
21	国发创投	STS221	苏州国发股权投资基金管理有限公司	P1002271
22	联新三期	SSP092	上海联新资本管理有限公司	P1060771
23	武汉光宏	SJY902	武汉光谷产业投资基金管理有限公司	P1064746
24	嘉兴豫富	STR229	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
25	朗玛七十三号	SXC578	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
26	嘉兴君晋	SSJ179	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
27	宁波先达	SQZ855	天津海达创业投资管理有限公司	P1001350
28	丽水同达	SLQ189	天津海达创业投资管理有限公司	P1001350
29	复星奥来德	SVQ267	上海复星创富投资管理股份有限公司	P1000303
30	广安小平	ST1924	广安小平故里发展基金管理有限公司	P1060546

除上述机构股东外，发行人其他机构股东不属于私募投资基金或私募基金管理人，具体情况如下：新沂强一、众强行一、知强合一系发行人持股平台，其资金来源于合伙人的自有或自筹资金，不存在非公开募集行为及委托管理的情况，也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续；联发利宝、Ondine、海风系在香港特别行政区注册成立的公司，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续；哈勃科技、丰聚年佳、松川科技、共青城芯微在设立过程中未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金，因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

第二节 保荐人承诺事项

一、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及上交所的有关业务规则，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐强一股份本次首次公开发行股票并在科创板上市，并据此出具本发行保荐书。

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，本保荐人就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐人对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

发行人聘请了募集资金投资项目可行性研究机构、韩国法务法人机构为本次公开发行并上市提供服务，具体情况如下：

（一）聘请募集资金投资项目可行性研究机构的情况

1、聘请的必要性

为合理论证本次公开发行并上市募集资金投资项目的可行性，发行人聘请深圳思略咨询有限公司对本次公开发行并上市募集资金投资项目提供可行性研究报告的咨询服务。

2、第三方的基本情况、资格资质和具体服务内容

深圳思略咨询有限公司事是专业从事咨询服务的公司，其具有相应的咨询服务资质，主要为发行人本次公开发行并上市提供可行性研究咨询服务。

3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

发行人与其通过友好协商确定合同价格，资金来源为自有资金，支付方式为银行转

账。深圳思略咨询有限公司服务费用为 15.00 万元（含税），已经支付 13.50 万元。

（二）聘请韩国法务法人机构的情况

1、聘请的必要性

为合理论证本次首次公开发行股票并在科创板上市中境外子公司的合法合规性，发行人聘请韩国法务法人施宪为发行人境外子公司出具境外法律意见书。

2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

法务法人施宪具有资格提供韩国法律意见，为发行人提供境外法律服务并出具韩国强一的法律意见书。

3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

发行人与其通过友好协商确定合同价格，资金来源为自有资金，支付方式为银行转账。法务法人施宪服务费用共 935.00 万韩元（含税），已经支付完毕。

经本保荐人核查，发行人相关聘请行为合法合规。

综上，发行人存在直接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定。

第四节 关于发行人利润分配政策的核查

经过对发行人本次发行上市后适用《公司章程（草案）》的核查，保荐人认为：发行人建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，《公司章程（草案）》关于利润分配的决策机制符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，发行人的利润分配政策和未来分红规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，注重给予投资者持续、稳定、合理的投资回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人的《公司章程（草案）》及招股说明书中对利润分配事项的规定和信息披露符合《监管规则适用指引——发行类第 10 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同时，报告期内公司未进行现金分红，且已经承诺在审期间不进行现金分红。

第五节 对本次发行的推荐意见

中信建投证券接受发行人委托，担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。本保荐人遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了审慎调查。

本保荐人对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价，对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了内部审核程序并出具了内核意见。

本保荐人内核部门及保荐代表人经过审慎核查，认为发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律、法规、政策规定的有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市。

一、发行人关于本次发行的决策程序合法

（一）董事会的批准

2024 年 11 月 20 日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

（二）股东大会的批准

2024 年 12 月 5 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，持有发行人 100%股份的股东或其代表出席了会议。会议审议通过了发行人董事会提交审议的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

二、本次发行符合相关法律规定

（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

1、公司自整体变更设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，结合公司实际情况逐步建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》等一系列公司治理制度，明确了股东会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

此外，发行人董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了科学和规范的治理制度。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》以及保荐人的审慎核查，发行人具有持续经营能力。

综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

综上所述，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人及其控股股东、实际控制人的说明、发行人提供的资料并经保荐人的审慎核查，截至本发行保荐书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯

罪。

综上所述，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

（二）本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、经核查发行人工商档案、纳税资料、发起人协议等资料，发行人前身强一有限成立于 2015 年 8 月 28 日。2022 年 8 月 15 日，强一有限召开股东会，同意强一有限以截至 2022 年 5 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司。2022 年 8 月 16 日，强一有限全体股东共同签署《强一半导体（苏州）有限公司发起人协议》，约定以强一有限截至 2022 年 5 月 31 日经审计的净资产 53,712.63 万元按 6.170483：1 的比例折股整体变更设立股份公司。2022 年 9 月 9 日，强一股份完成工商变更登记。

经核查发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，发行人相关会议文件，组织机构安排等资料，并访谈发行人高级管理人员，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，本保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

2、经核查发行人内部控制流程、内部控制制度、会计记录、记账凭证、立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》、立信会计师出具的《内部控制鉴证报告》等资料，并访谈发行人财务负责人，本保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编

制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

3、经核查发行人业务经营情况、工商档案、主要资产权属证明文件、控股股东、实际控制人调查表、立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》等资料，并访谈发行人高级管理人员，本保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

4、经核查发行人报告期内主营业务收入构成、重大销售合同、主要客户资料等资料，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化；经核查发行人工商档案，聘请董事、高级管理人员的相关会议决议，核心技术人员的《劳动合同》，发行人最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，发行人核心技术人员稳定且最近两年内没有发生重大不利变化；经核查发行人工商档案，控股股东、实际控制人访谈文件等资料，最近两年发行人的实际控制人始终为周明，未发生变更。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。本保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

5、经核查发行人主要资产清单、主要资产权属证明文件、立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》、发行人律师出具的《法律意见书》等资料，本保荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

6、经核查发行人主营业务情况，相关主管机构出具的有关证明文件，并经公开信息查询，本保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、

挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

（三）本次证券发行符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的规定

1、发行人符合科创板行业领域的规定

发行人是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“鼓励类”产业。

综上所述，发行人所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域——半导体和集成电路”行业领域的要求。

2、发行人符合科创属性要求的规定

2021-2023 年度，发行人研发投入分别为 1,999.25 万元、4,604.11 万元和 9,297.13 万元，合计研发投入金额 15,900.48 万元；公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 22.13%。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第一款的规定。

2023 年末，发行人研发人员 116 人，占当年末员工总人数的比例为 18.89%，已超过 10%。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第二款的规定。

截至本发行保荐书签署日，发行人拥有可应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 67 项，已超过 7 项。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第三

款的规定。

2021-2023 年度，发行人营业收入分别为 10,977.20 万元、25,415.71 万元和 35,443.91 万元，发行人最近三年营业收入复合增长率为 79.69%，已超过 25%；最近一年营业收入金额为 35,443.91 万元，已超 3 亿元。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第四款的规定。

发行人不属于金融科技、模式创新企业，不属于房地产和主要从事金融、投资类业务的企业。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第三条的规定。

三、发行人的主要风险提示

（一）客户集中度较高及对关联客户存在重大依赖的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 49.11%、62.28%、75.91%和 72.58%，集中度较高；同时，由于公司客户中部分封装测试厂商或晶圆代工厂商为 B 公司提供晶圆测试服务时存在向公司采购探针卡及相关产品的情况，若合并考虑前述情况，公司来自于 B 公司及已知为其芯片提供测试服务的收入分别为 2,759.84 万元、12,781.77 万元、23,915.10 万元和 13,984.53 万元，占营业收入的比例分别为 25.14%、50.29%、67.47%和 70.79%，公司对 B 公司存在重大依赖。

B 公司是全球知名的芯片设计企业，拥有较为突出的行业地位，其芯片系列多且出货量大；同时，由于其芯片设计能力较强，所采购中高端探针卡较多，其探针卡平均探针数量更多，使得产品技术附加值、单价及毛利率均相对较高。报告期内，公司经营业绩的增长主要依赖于 B 公司对于晶圆测试探针卡需求的快速增长。

目前，公司与境内诸多知名半导体厂商或其下属公司建立了稳定、良好的合作关系，尽管公司在积极进行其他大客户的拓展，但由于公司下游市场格局以及产品研发验证周期等因素，预计在未来一定时期内仍将存在对以 B 公司为首的主要客户销售收入占比较高的情形。如果未来公司与主要客户（特别是 B 公司）的合作关系或下游市场的行业格局发生变化，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

（二）供应商集中度较高且对部分原材料单一或少数供应商同类采购占比较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为 2,058.32 万元、6,663.80 万元、5,221.34 万元和 3,562.31 万元，占采购总额的比例分别为 38.97%、49.14%、40.19%和 60.27%，集中度较高，主要系采购探针卡所需的 PCB、MLO、贵金属试剂以及探针等。

由于部分原材料的稀缺性，公司存在向单一或少数供应商采购金额占同类原材料采购金额比重较高的情形。公司系综合考虑供应商产品质量、合作历史以及交期等，基于最大限度保证产品交付的稳定性、及时性，采取同种原材料主要通过单一或少数供应商采购的经营策略。公司报告期各期前五大供应商中除南通圆周率系公司实际控制人控制的企业外，其余均与公司无关联关系，而且主要系境外厂商或其境内分支机构。如果未来公司与相关供应商合作关系发生变化，或相关供应商自身经营状况、交付能力发生重大不利变化，再或由于国际形势等因素无法进行正常交易，公司无法及时采取有效的替代措施，均将对公司经营业绩产生重大不利影响。

（三）毛利率及经营业绩下降的风险

报告期内，受探针卡国产替代进程加速、公司毛利率较高的 MEMS 探针卡收入占比提高等因素影响，公司毛利率分别为 35.92%、40.78%、46.39%和 54.03%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-377.36 万元、1,384.07 万元、1,439.28 万元和 3,660.82 万元，均呈现良好的增长趋势。

根据 TechInsights 的数据，2023 年半导体产业处于下行周期，全球探针卡市场规模有所下降。若公司无法继续扩大主要产品市场份额、有效提升产品销售价格、控制关键原材料采购价格、提高产品制造良率，或因探针卡行业市场竞争加剧、晶圆测试需求减少等因素影响，都可能导致公司毛利率及经营业绩出现下降。

（四）营业收入无法保持快速增长的风险

报告期内，公司营业收入分别为 10,977.20 万元、25,415.71 万元、35,443.91 万元和 19,753.74 万元，保持持续快速增长，其中 2021-2023 年度复合增长率为 79.69%。从产品角度来看，公司营业收入的增长主要来自于 2D MEMS 探针卡销售收入增长；从客户角度来看，公司营业收入的增长主要来自于 B 公司以及为其提供晶圆测试服务的厂商；

从行业角度来看，主要应用于存储领域的 2.5D MEMS 探针卡是公司未来重要的收入增长点。

因此，若未来公司无法持续保持 2D MEMS 探针卡竞争优势，或与 B 公司合作关系发生变化，再或 2.5D MEMS 探针卡市场推广速度不及预期，都可能导致公司营业收入无法保持快速增长。

（五）关联交易金额较大的风险

报告期内，公司关联销售占营业收入的比例分别为 24.93%、38.88%、40.09%和 44.12%，呈现逐步上升的趋势。公司关联销售占营业收入的比例较高，主要是由于公司于 2020 年、2021 年分别推出的 2D MEMS 探针卡、薄膜探针卡获得 B 公司的认可，随着 B 公司业务快速发展，其对公司采购金额快速增长，公司基于实质重于形式原则将 B 公司认定为关联方；同时，公司外部机构投资者提名的董事、监事在半导体企业兼职较多，其中部分企业为公司客户。

为保证供应链稳定性，公司逐步在境内寻找产品核心部件及材料供应商。其中，报告期内，公司向南通圆周率采购 PCB、MLO 等产品及 PCB 贴片服务，其采购金额占营业成本的比例分别为 0.75%、18.32%、8.91%和 8.93%，南通圆周率系公司实际控制人周明控制的企业。

未来公司预计将持续发生上述关联交易，公司关联交易，特别是关联销售金额相对较大、占比相对较高，对公司经营业绩影响较大。

（六）综合竞争力与境外探针卡厂商存在差距的风险

目前，探针卡行业由境外厂商主导。根据 TechInsights 的数据，探针卡行业前十大厂商多年来均为境外厂商，合计占据了全球 80%以上的市场份额。境外探针卡厂商成立时间久、进入市场早、经营规模大、研发投入高，并面向全球市场提供服务，具有市场竞争优势。公司在技术实力、产品稳定性以及全球服务能力等方面较境外厂商仍存在不同程度的差距。如果公司不能有效提升自身综合竞争力、提升产品品质或在境外拓展业务的过程受到政策、法律法规、政治等方面的限制，则将对公司拓展客户、扩大经营规模等方面带来不利影响。

（七）未能保持与半导体技术同步发展的风险

公司聚焦晶圆测试所需核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。随着半导体制造工艺越来越先进，器件越来越复杂和精细，晶圆测试的要求越来越具有挑战性。因此，公司必须不断进行产品研发创新才能满足日益复杂的晶圆测试新要求。如果公司无法通过技术创新保持与半导体技术的同步发展，或者公司无法精准判断行业技术发展的趋势、及时应对行业技术的重大变革，则将影响公司产品的竞争力，进而对公司的生产经营产生不利影响。

（八）半导体产业周期性波动风险

公司所处的半导体行业具有周期性，其特点是产品供需波动较大，主要和产品成熟与技术突破的更迭、产能周期以及宏观经济走势有关。根据 WSTS 的数据，受终端需求疲软影响，全球半导体行业自 2022 年下半年进入周期性低迷，行业市场规模 2023 年同比下降 8.3%至 5,269 亿美元；随着以人工智能、算力为代表的市场需求充分释放，2024 年全球半导体行业有望实现 16.0%的回升，达到 6,112 亿美元。

探针卡行业与半导体行业的变动直接相关，例如芯片设计厂商的新产品研制、量产产品的出货，晶圆制造厂商的产能及稼动率等。当行业处于下行周期时，终端需求疲软可能会对公司的收入、毛利率产生不利影响，此外持续的低迷可能引致一个或多个客户的偿付能力受损，进而影响公司回收应收账款的能力。因行业周期性低迷的时间、长度和严重程度难以预测，如果公司未能做好计划或及时采取应对措施，则将对生产经营产生不利影响。

四、发行人的发展前景评价

（一）发行人所处行业前景广阔

1、长期来看，半导体产业扩张态势将带动探针卡行业持续发展

从半导体产业下游来看，作为通信、计算机、消费电子、汽车电子以及工业等领域不可替代的功能器件，尽管存在周期性波动，但半导体产品的需求长期仍将持续向好发展。一方面，半导体产品的应用端向着轻薄化、高效能、低功耗的方向发展；另一方面，随着近年来科技创新技术的不断成熟和应用，云服务、人工智能、物联网、新能源等新

兴行业迎来快速发展，将成为半导体产品新的增长点，前述因素均要求探针卡具备更优良可靠的性能，因而牵引探针卡的价格和数量同步发展。

从半导体产业上、中游来看，因晶圆测试的需求与晶圆制造厂商的产能及稼动率存在直接关系，晶圆制造产能的快速增长，势必带动探针卡需求持续发展。近年来，全球主要国家开始重视半导体供应链安全性问题，均出台产业刺激政策，尤其聚焦半导体生产与制造环节：日本于 2021 年 12 月通过半导体投资预算以支持半导体生产；韩国于 2022 年 1 月通过《半导体特别法》，对半导体产业提供包括投资、研发、人才培养在内的全方位支持；欧盟于 2022 年 2 月通过《欧洲芯片法案》，旨在提升欧洲半导体产品产能；美国于 2022 年 8 月通过《芯片与科学法案》，通过资金支持及税务抵免鼓励在美国本土进行半导体的研发与制造。受国际形势以及国内政策等推动，我国主要厂商亦在不断增加产能，根据麦肯锡的数据，2023-2026 年，全球待建晶圆厂数量将达 60 余个，其中境内待建晶圆厂约为 21 个，占比约 30%。全球晶圆制造产能的增加势必进一步释放晶圆测试需求。

综上，半导体产业长期来看呈向好发展的态势确定性较强，探针卡行业具备持续发展的基础。

2、国际政治环境推动和国内政策利好双重驱动半导体产业链国产替代进程加速

近年来，美国对中国半导体产业的限制持续加剧。2017 年 1 月，美国总统科学技术咨询委员会发布《确保美国半导体的领导地位》，宣称中国的半导体发展对美国构成了“威胁”。2022 年，美国总统拜登签署《芯片与科学法案》，禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，同年 10 月美国商务部工业与安全局对《出口管理条例》进行修订，进一步限制中国在先进计算、半导体制造领域获得或使用美国产品及技术。2023 年 1 月，美国携日本、荷兰建立半导体设备供应联盟，进一步管制半导体生产设备对中国的供应；当年 10 月美国商务部工业与安全局更新了对先进计算集成电路、半导体制造设备以及支持超级计算应用和最终用途的物项向包括中国等国家的出口管制措施。2024 年 12 月，美国商务部工业与安全局将 140 个中国实体列入“实体清单”，主要为国产半导体制造、设备厂商；同时新增了对 HBM 的相关限制和多类高端设备的管制。

在全球主要国家均不同程度重视自身半导体供应链安全性以及美国等持续对我国

半导体产业进行限制的背景下，我国半导体产业国产替代迫在眉睫。因此，国家出台了一系列产业政策，旨在突破半导体各关键“卡脖子”环节、提升我国半导体产品自给率、加强半导体产业链的自主可控性，为行业的发展营造了良好的政策环境和机遇。

综上，在国际政治环境推动和国内政策利好的推动下，半导体产业链国产化率有望快速抬升，随着国产化趋势传导，境内半导体参与者对其国产替代供应商的扶持有望持续增加，国产化进程有望进一步加速。

3、半导体技术不断发展，晶圆测试重要性进一步显现

在半导体制程方面，“摩尔定律”认为半导体上可容纳元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。长期以来，“摩尔定律”一直引领半导体制程技术的发展与进步。“摩尔定律”下，半导体的制程越先进，芯片单位面积能够容纳的晶体管数量越多，性能越强大，功耗也越低。但每代制程开发及制造成本呈指数级提升，导致封装阶段的要求也愈加严苛。

随着芯片制程开发难度的加大，以及高端制程制造成本的指数级提升，半导体制造行业步入“后摩尔时代”。“后摩尔时代”半导体技术发展存在两个主要技术方向：SoC 和 SiP。SoC 是从设计和晶圆制造角度出发，将系统所需的组件和功能集成到一枚芯片上，核心系通过设计和制造将数个不同功能的芯片经同样制程集成于单一芯片上；SiP 则是从封装角度出发，将不同功能的芯片和元器件集成到一个封装体内，核心系通过封装将不同制程的芯片封装在一个系统内。两种技术的发展使得半导体产品结构愈加复杂化，封装环节的成本显著提升，从而要求晶圆测试探针卡装配更多探针、具备更密集的排针以及更复杂的结构以满足更为严苛的测试要求。

综上，随着半导体技术向先进化制程、SoC 及 SiP 等技术方向发展，在封装前实施晶圆测试的重要性将进一步显现，进而带动探针卡行业的发展。

4、探针卡技术的深化发展紧密围绕半导体产业的发展趋势

探针卡是晶圆测试所需的一种高复杂性、高精密型、高定制化的消耗型测试硬件。因不同厂商、不同芯片的设计与制造均可能存在差异，探针卡厂商需要根据待测标的类型、架构、制程、工艺、应用领域、功能和性能等制定探针卡技术方案，在进行探针卡设计时，需要考量探针材质、PCB 工艺、基板、针数、针距、测试环境等诸多因素。

随着产业技术水平的提高和下游需求的引导，探针卡技术将持续深化发展。从探针卡技术方案来看，随着半导体制造工艺越来越先进，器件越来越复杂和精细，晶圆测试环节的难度和成本越来越高，探针卡需要更精密、更高效、更耐用、更稳定，因而其在结构、组件、材料、制造工艺等方面均存在技术持续发展的空间。从芯片终端应用领域来看，基于云服务、人工智能、物联网、新能源等新兴产业的发展，芯片在高速信号传输、高效计算、高频信息交换以及复杂环境工作等方向均存在性能提升需求，探针卡需要针对前述方向进行更具针对性的测试，从而更好满足客户需求。

综上，探针卡技术的深化发展将持续紧密围绕半导体产业的发展趋势。

（二）发行人在行业内具备较强的竞争优势

1、技术能力及创新优势

结合行业发展趋势，公司在 MEMS 探针卡方面持续加大研发投入、加强自主创新，实现了良好的产业化。报告期内，公司研发投入合计 19,053.50 万元，占营业收入比例达 20.80%；同时，公司 MEMS 探针卡收入分别为 5,626.21 万元、13,599.82 万元、23,474.51 万元和 14,467.56 万元，占营业收入的比例分别为 51.25%、53.51%、66.23%和 73.24%，带动公司营业收入快速增长。

公司拥有自主 MEMS 探针制造技术并能够批量生产 MEMS 探针卡，形成了较为成熟的设计、生产模式，在形成产品所需的关键工艺环节逐步凝练了专业能力、积累了关键技术，具体如下：

项目	MEMS 探针卡		非 MEMS 探针卡	
	2D MEMS 探针卡	薄膜探针卡	垂直探针卡	悬臂探针卡
探针设计及制造能力	√	√	-	-
探针卡 PCB 设计能力	√	√	√	√
空间转接基板设计能力	√	不涉及	√	不涉及
探针卡设计能力	√	√	√	√
探针卡装配能力	√	√	√	√

经过持续的研发投入、自主创新和技术积累，公司在探针卡所需关键工艺环节形成了专业技术能力。截至本发行保荐书签署日，公司掌握 24 项核心技术，取得授权专利 171 项，其中发明专利 67 项。

技术创新是公司发展的动力源泉，公司将以市场及客户需求为导向、以前沿技术为引领，整合现有技术资源、完善技术创新体系、持续加大技术研发与创新投入、引进专业技术人才，为公司的持续创新提供保障，从而增强公司核心竞争力。

2、产品国产化优势

一直以来，探针卡行业被境外厂商主导，由于探针卡是半导体产业重要制程所需的核心硬件，对其实现自主可控、进口替代具有重要意义。公司是目前境内极少数拥有自主 MEMS 探针制造技术并能够批量生产、销售 MEMS 探针卡的厂商，具有国产化优势。

近年来，我国半导体产业迅速发展，我国探针卡行业进一步快速发展的潜力巨大，在美国对中国半导体产业的限制持续加剧等国际事件的推动下，以发行人为代表的国产探针卡厂商具有良好发展空间。由于探针卡定制化程度高，应用要求差异大，厂商需要与客户进行紧密的沟通交流才能实现测试要求，随着公司较为全面地覆盖境内半导体产业主要参与者，叠加相关客户对供应链国产化的扶持力度提升，未来公司产品渗透率进一步提升的确定性较强。

因此，公司通过不断深化与客户的合作，积极提升产品性能、拓展产品丰富度，进一步提升自主产品的竞争力，进而加速实现产品国产化。

3、客户资源优势

因探针卡定制化属性以及客户技术保护等因素，探针卡行业具有较高客户资源壁垒。凭借深入的需求理解、扎实的技术实力、丰富的交付经验以及可靠的规模化生产能力，公司产品及服务得到客户认可。报告期内，公司单体客户数量合计超过 370 家，较为全面地覆盖了境内芯片设计厂商、晶圆代工厂商、封装测试厂商等多类产业核心参与者。

通过与客户建立持续、稳定的合作关系，一方面公司能够准确、快速、及时地把握客户需求，提前感知行业变化的趋势，并为此进行相关的技术储备，从而能够针对客户需求做出快速响应，参与到客户新产品的同步测试验证中去，不断提升对客户的渗透水平，进一步拓展合作范围，提升客户粘性；另一方面与产业知名厂商合作能够形成一定示范效应，使得公司在订单获取能力、增强客户黏性、人才引进等方面受益。

4、团队及人才优势

探针卡行业属于智力密集型行业，管理团队、研发团队和生产技术团队是保持公司持续经营能力、技术创新能力、产品交付能力的核心资源。相关人员在具备必要的知识、充分的理论的基础上，还需要丰富的实践经验、强大的执行能力。

自成立以来，公司专注于探针卡的研发、设计、生产与销售，公司创始团队相关人员具有近 20 年探针卡或相关行业从业经验，对行业及技术发展趋势具有深刻理解。目前，公司已建立一支专注探针及探针卡技术创新的研发团队。公司核心技术人员具有针对性的专业知识、良好的教育背景以及丰富的研究经验，为公司持续自主创新奠定坚实基础。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员 116 名，专业领域涵盖机械、自动化、光电、材料以及电子信息工程等，具备探针卡相关领域设计、制造方面知识储备。公司研发团队拥有较高的技术水平与研发能力，多年来在 MEMS 探针、MEMS 探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等领域实现了多项技术突破并积累了可观的研发成果。报告期内，公司凭借可靠的生产能力，累计交付各类 MEMS 探针卡超过 1,700 张，充分满足各类客户的不同测试需求。

5、规模化产线优势

探针卡属于资本密集型行业，必要的资本投入是探针卡厂商服务客户的基础，先进的设备有助于探针卡厂商加强核心竞争力。经过多年发展，公司生产体系逐步完善并陆续建立了配备先进研发设备、生产设备的实验室、工厂，拥有从 MEMS 探针制造到 MEMS 探针卡制造的完整产线，目前已拥有两条 8 寸 MEMS 产线和一条 12 寸 MEMS 产线，初步实现公司探针卡核心部件的自主可控。公司拥有专业的管理、研发、工程技术和生产团队，配备专业的生产、研发设备，并建立了百级、千级等无尘工厂，有效提升产品交付能力，保证了产品的品质。

6、产业集群及服务优势

从产业集群角度来看，长三角区域经济发达、工业基础雄厚，目前已经形成较为完整的半导体产业链。根据公开数据，长三角区域半导体产业市场规模占全国 50%以上，是我国最主要的半导体产业集群区域。公司总部位于苏州，并在合肥、上海、南通等地设立分支机构，有效辐射长三角区域。由于探针卡的高度定制化特征，良好的区域覆盖

可以更为及时有效地满足客户需求，行业主要厂商在其发展过程中，均存在主要围绕本地区域客户进行服务的情况。

从服务角度来看，对于境内客户：一方面，相比境外探针卡厂商，公司可以提供专业性强、响应速度快的服务，可以更好地帮助客户节约时间成本，提高解决问题效率；另一方面，公司可借助于地缘优势，更为便捷地为境内客户提供本土化、特色化服务。

（三）发行人制定了清晰的未来发展战略和发展规划

自成立以来，公司专注于探针卡的研发、设计、生产和销售，致力于协助客户降低制造成本、提高产品良率。凭借深入的需求理解、扎实的技术实力、丰富的交付经验以及可靠的规模化生产能力，公司产品及服务得到客户认可。公司与境内诸多知名半导体厂商或其下属公司建立了稳定、良好的合作关系，报告期内，公司经营规模快速增长，2021-2023 年度营业收入复合增长率达 79.69%。未来，公司将持续加大研发创新力度，以满足不同客户各类晶圆测试需求为目标，不断提升产品性能、扩充产品种类，深化既有客户服务能力的同时积极拓展境内外新客户，力争成为具有全球市场竞争力的国产探针卡厂商。

在半导体产业快速发展以及国产替代进程加速的背景下，国产探针卡厂商迎来了更为广阔的发展空间。未来，公司在 MEMS 探针卡方面将不断丰富产品的应用领域，进一步提升 2D MEMS 探针卡的市场份额，并积极推动薄膜探针卡、2.5D/3D MEMS 探针卡的大规模量产及交付；在非 MEMS 探针卡领域，公司将通过强化产品性能、提升服务效率、聚焦龙头客户等方式不断巩固市场竞争力。

短期来看，对于 2D MEMS 探针卡，公司将立足以手机 AP 为代表的非存储领域竞争优势，重点布局面向算力 GPU、CPU、NPU 以及 FPGA 等领域的高端产品及客户的拓展。对于薄膜探针卡，公司产品目前最高测试频率达到 67GHz，技术方面力争实现 90GHz 的突破。对于 2.5D MEMS 探针卡，尽快实现国产存储龙头合肥长鑫、长江存储的合格供应商认证以及面向兆易创新的产品交付，重点布局面向 HBM 领域产品的研制，实现面向高端 CIS 的大规模出货。

长期来看，公司将不断深入探针卡前沿技术研发、提升产品丰富度、提高产品性能、增强产品品质。产品方面，公司不断引领 2D MEMS 探针卡方面的技术创新，努力实现薄膜探针卡 110GHz 的技术攻关，力争实现面向 DRAM 芯片的 3D MEMS 探针

卡的研制。技术方面，公司努力实现探针卡更高程度的自主可控，对于 2D MEMS 探针卡，力争实现以玻璃为材料的空间转接基板的生产制造，同时深耕探针原材料电镀液的自主研制；对于 2.5D/3D MEMS 探针卡，力争突破 MLC 的全过程制造能力。

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况

公司财务报告的审计截止日为 2024 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本发行保荐书签署日，公司所面临的国家产业政策、税收政策等未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业务模式、行业市场情况及竞争趋势未发生重大变化，公司与主要客户、供应商的合作关系未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论

受发行人委托，中信建投证券担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐人内核部门的审核。保荐人对发行人本次发行的推荐结论如下：

本次强一股份首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信建投证券同意作为强一股份本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名：

李书春

保荐代表人签名：

郭家兴　　张宇辰

保荐业务部门负责人签名：

王炳全

内核负责人签名：

张耀坤

保荐业务负责人签名：

刘乃生

总经理签名：

金剑华

法定代表人/董事长签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

2024年12月22日

附件：

保荐代表人专项授权书

本公司授权郭家兴、张宇辰为强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，履行该公司首次公开发行股票并在科创板上市的尽职推荐和持续督导的保荐职责。

特此授权。

保荐代表人签名：郭家兴　　张宇辰

郭家兴　　张宇辰

法定代表人/董事长签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

2024年12月22日